

证券代码：300480

证券简称：光力科技

债券代码：123197

债券简称：光力转债

光力科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20260313

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（投资者电话交流会）
参与单位名称及人员姓名	太平养老保险：张凯；百年保险：李翹楚；野村东方证券：徒月婷；豪世私募：钟兆繁；利幄基金：孟舒豪；西藏青骊：王伟淼；南土资产：王可；瞰道资产：武钰婷；东方证券：曹伏飙；信达澳亚基金：朱然、邵广雨；西藏合众易晟投资：唐紫阳；趣时资产：葛翔；杭州附加值投资：刘亚群；华能贵城信托：王宁；上汽集团尚颀投资：宋明；北方紫薇基金：秦兴；国金证券：樊志远、周焕博
时间	2026年3月12日、2026年3月13日
地点	公司郑州航空港厂区2号楼会议室、线上交流（电话会议）、成都
上市公司接待人员姓名	总经理、董事：胡延艳 证券事务代表：关平丽
投资者关系活动主要内容介绍	<p>管理层介绍了公司的经营业绩情况，并就投资者关注的问题进行交流，部分投资者实地参观了公司生产车间和展厅区域。公司参加了2026年3月13日国金证券策略会，并回复了相关问题。</p> <p>主要沟通交流内容如下：</p> <p>1、截至目前，公司2025年和2026年各业务发展情况如何？</p> <p>答：感谢您的关注！受益于公司国产化划切设备在先进封装领域更广泛的应用，以及半导体行业上行发展机遇，2025年7月以来，公司国产半导体设备处于持续满产状态。进入2026年，客户提货速度和提货量也延续2025年下半年态势；公司通过提升生产效率、充分利用航空港厂区和高新厂区基础设施等多种措施提升产能，以更好的满足客户的交付需求。公司物联网业务保持稳定发展，谢谢！</p> <p>2、公司国产半导体业务新产品的验证情况如何？</p> <p>答：公司激光开槽机、激光隐切机、研磨机和硬刀产品正在客户端</p>

验证；研磨抛光一体机正在研发中。公司全力加快推进设备验证尽快形成销售订单。

3、公司国产半导体业务目前已满产，后续如何提升现有产能；二期项目预计什么时候可以实现满产？

答：公司将通过提升现有产能的生产效率以及充分利用高新厂区的基础设施扩充产能；航空港厂区二期项目预计在 2027 年一季度全部建成投产，为更好的满足客户的交付需求，公司将采取边建设边投产的方式；公司也将根据市场需求变化动态调整产能提升的进度。

4、公司国产化空气主轴已经实现外销了吗，主要用于哪些领域？

答：公司国产化切割主轴已运用到部分国产化划切设备中并于 2025 年开始对外销售。国产空气主轴已经批量应用于半导体制造领域的切割、研磨、硅片生产、光学检测等设备，和精密加工领域如接触式透镜行业的金刚石车削等设备。

5、公司在激光划片机领域有什么布局，分别对应什么场景？

答：目前公司完成研发的激光划片机产品有激光开槽机和激光隐切机；其中，激光开槽机可以用于 Low-k 薄膜、氮化铝、氧化铝陶瓷等材料的加工；激光隐切机可以用于抗污垢性能差的工件和抗负荷能力差的工件（如超薄硅晶圆、MEMS 器件等）以及第三代半导体器件等芯片的切割。

6、以色列 ADT 目前生产经营是否正常，受中东局势影响有多大？

答：目前 ADT 工厂的厂房、设备及人员均安全，子公司运营稳定。ADT 工厂系以色列政府白名单企业，在紧急状态与战争时期获准正常开工，并享受安全保护。

过去两三年间，受地缘政治影响，工厂除阶段性物流运输受影响外，生产、研发基本未受干扰。公司英国工厂和郑州工厂也为 ADT 子公司提供生产协同和采购支持等，保证客户订单的交付，最大限度降低外部环境对客户的影响。公司也将持续跟踪局势变化，充分与相关各方紧密沟通，全力守护海外员工安全与产业供应链稳定，敬请注意投资风险。

7、公司强制赎回可转债是出于什么考虑？

答：结合当前市场及公司自身情况，经过全面、审慎的考虑，公司

	<p>决定行使“光力转债”的提前赎回权利，可转债赎回的相关事宜请关注公司在巨潮资讯网披露的相关公告。</p> <p>可转债转股或赎回后可减少公司财务费用的计提和未来利息费用支出，有利于公司实现高质量可持续发展。公司将努力提升业绩，不断提升公司综合竞争实力；公司也将进一步加强投资者关系管理工作，向更多投资者传递公司投资价值。</p> <p>8、公司后续还有什么融资计划？</p> <p>答：为积极响应国家科技创新政策导向，加大科技创新投入力度，为公司半导体封测装备的研发生产、业务拓展等核心业务活动提供中长期资金支持，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行最高不超过人民币5亿元(含5亿元)科技创新债券。本次科技创新债券发行尚需提请公司股东会审议批准以及中国银行间市场交易商协会的批准，后续进展请关注公司相关公告。</p> <p>如有其他融资计划，公司也将及时履行相关程序和信息披露义务。敬请注意投资风险。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2026年3月13日